

絶縁性と熱伝導性を両立

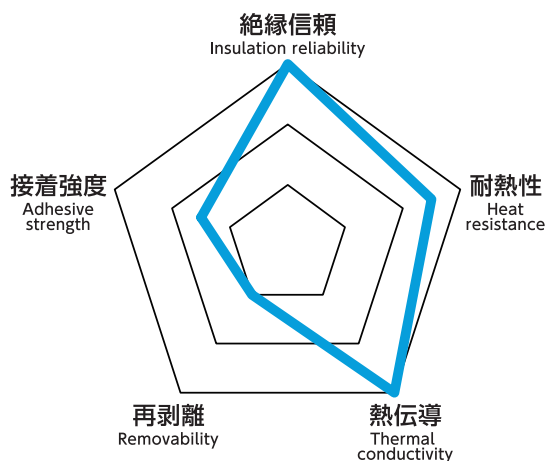
Electrical insulation and thermal conductivity

コンセプト Concept

- 安定した熱伝導率、絶縁破壊強度
Stable thermal conductivity and dielectric breakdown strength
- 熱硬化樹脂による高信頼性
High reliability by using thermosetting resin
- 接着剤や構成のカスタマイズ可能
Customizable adhesives and layer configurations

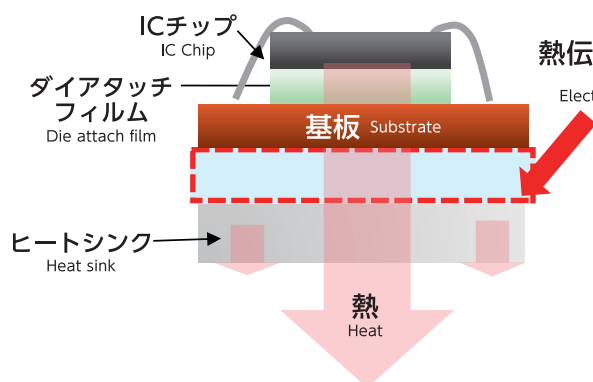
項目 Item	代表値 Data
熱伝導率 Thermal conductivity	3.5w/m・K
絶縁破壊強度 Dielectric breakdown strength	AC65kV/mm
せん断強度 Shear strength	2.6MPa
ピール強度 Peel strength	8.1N/cm
熱膨張係数<Tg CTE < Tg	20ppm
ハンダ耐熱 Solder heat resistance	300°C/10min

※上記数値は代表値であり保証値ではありません The data are references, not guaranteed values.



アプリケーション Application

- デバイスやチップの放熱
Heat dissipation of devices and chips
- 基板との絶縁
Electrical insulation from substrates



熱伝導絶縁接着フィルム
Thermal Conductivity
Electrical Insulating Adhesive Film

